

## 2018 年度精密工学会春季大会公開シンポジウム

### “レーザおよびレーザ援用加工の新展開”

開催日 平成 30 年 3 月 16 日(金)

主催：精密工学会

企画：中部大学生産技術開発センター(センター長：鈴木浩文)

協賛：精密工学会東海支部，レーザー学会，レーザ協会，応用物理学会(申請中)，日本機械学会(申請中)，塑性加工学会(申請中)，電気加工学会(申請中)，砥粒加工学会(申請中)，レーザ加工学会(申請中)

趣旨：1960 年のレーザ誕生から半世紀余が経過し，レーザは計測・通信・記録・表示・診断・治療・核融合のほか，切断・溶接・熱処理・表面処理・露光などの加工の分野でも広く利用されるようになった。炭酸ガスレーザと YAG レーザによる切断・穴あけと溶接が主要なレーザ加工技術であるが，最近ファイバーレーザや半導体レーザなどの新しいレーザの出現や新しいレーザ加工技術の誕生が国内外であり，益々その応用分野が広がっている。今回のシンポジウムでは，将来への発展を見据えた話題を集めました。新しいレーザ加工の動向を知る良い機会だと思います。公開シンポジウムとして無料で開催としましたので，関係各位の積極的なご参加を期待しています。

開催日時：平成 30 年 3 月 16 日(金)午前 9 時より

会 場：中央大学後楽園キャンパス(東京都文京区春日 1-13-27)

5 号館 2 階 5234 号室(講演室 B)

使用言語：日本語と英語(海外からの講師の場合)

参加費：無料

プログラム：

1. 9:00～ 9:05 “はじめに”  
中部大学 鈴木 浩文氏
2. 9:05～9:40 “レーザ加工の最新動向—ものづくりの中のレーザ加工—”  
中央大学 新井 武二氏
3. 9:40～10:20 “新しいレーザ切断プロセス KABRA”  
(株)ディスコ 平田 和也氏
- 10:20a～10:35 休 憩
4. 10:35～11:15 “超短パルスによる非金属材料のレーザ接合”  
岡山大学 岡本 康寛氏
5. 11:15～11:55 “青色半導体レーザを用いたアディティブマニュファクチャリング”  
大阪大学 塚本 雅裕氏
- 11:55～13:00 昼 食
6. 13:00～13:40 “Micro Processing with High Average Power Ultrafast Laser”  
TRUMPF Scientific Lasers GmbH + Co. KG Thomas Metzger 氏
7. 13:40～14:20 “Precision diamond turning of difficult-to-cut materials assisted with laser beam”  
Micro-LAM Inc. Deepak Ravindra 氏
8. 14:20～14:25 “おわりに”

中部大学 難波 義治氏

9. 14:25~15:30 名刺交換会（上記講演に関するポスターを展示します。講師の方々との交流を深めて下さい。）

**会場案内：**東京メトロ丸ノ内線・南北線『後楽園駅』から徒歩 5 分，都営三田線・大江戸線『春日駅』から徒歩 6 分，JR 中央・総武線『水道橋駅』から徒歩 12 分

**参加申込：**精密工学会ホームページ <http://www.jspe.or.jp/>（2018 年 2 月初旬公開予定）  
公開シンポジウムのみ参加の場合は無料です。但し、シンポジウム資料集（他のシンポジウムの内容を含む）は学会員および共催学会員 5,000 円、非会員 6,000 円で販売しています。

**詳細問合せ先：**精密工学会 大会係（URL:<http://www.jspe.or.jp>, E-mail: [jspe\\_taikai@jspe.or.jp](mailto:jspe_taikai@jspe.or.jp), TEL:03-5226-5191）